

2023.7.25 ニュースリリース

「続報」三次元実装およびファンアウト半導体パッケージ用『ウエハハンドリングシステム装置』大口受注のお知らせ

AIメカテック株式会社(本社:茨城県龍ヶ崎市向陽台、社長:阿部 猪佐雄)は、大手OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)企業よりウエハハンドリングシステム装置を新たに受注を致しましたので以下の通りご報告申し上げます。

5G、IoT、AI及び自動運転市場などの成長を背景に三次元実装(2.5Dおよび3D)およびファンアウト半導体パッケージに対するニーズは堅調に推移しており、更なる薄化・積層化が求められております。

当社のウエハハンドリングシステム装置は薄化・積層化に対し重要なプロセスの一つを担っております。長年培ってきたウエハの仮接合技術及び薄化後のウエハからサポートガラスを剥し洗浄するプロセス技術に、当社のモノづくり力を融合し、高性能ウエハハンドリングシステム装置をご提案して参りました。その結果、新たに大手OSAT企業から高い評価を頂き大口の受注に至りました。現在、多数の半導体パッケージ製造企業から引合を受けており、歩留り率向上を実現できる当社設備の採用が検討されております。

当社は、今後も製造プロセスのイノベーションを通してより便利で豊かな生活スタイルの向上により社会に貢献できる企業を目指して参ります。

お問い合わせ

AIメカテック株式会社

営業部 TEL:0297-62-9119

<https://www.ai-mech.com/>